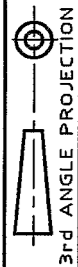


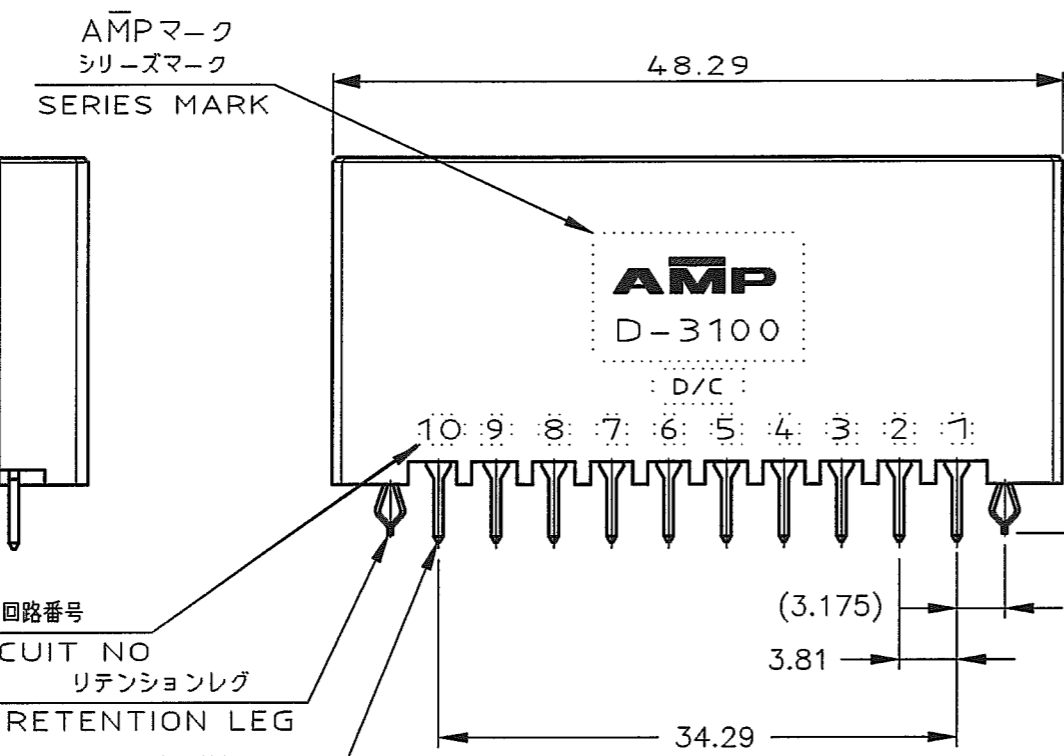
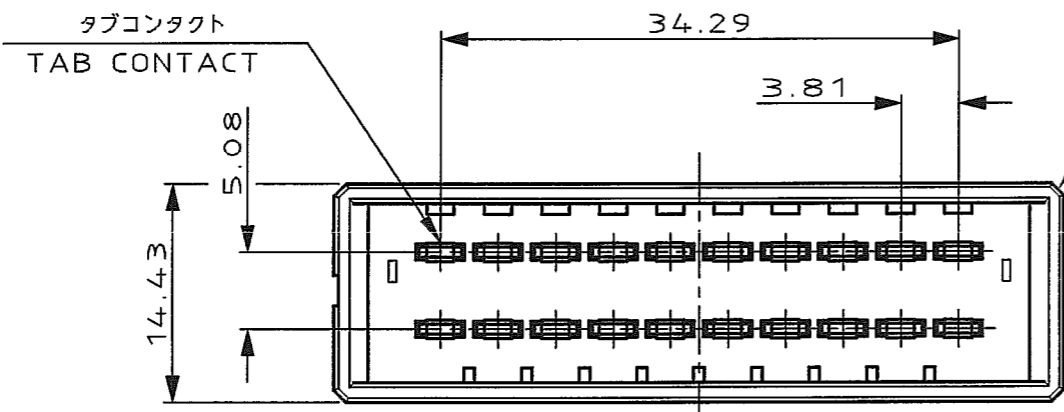
NUMBER  
178328



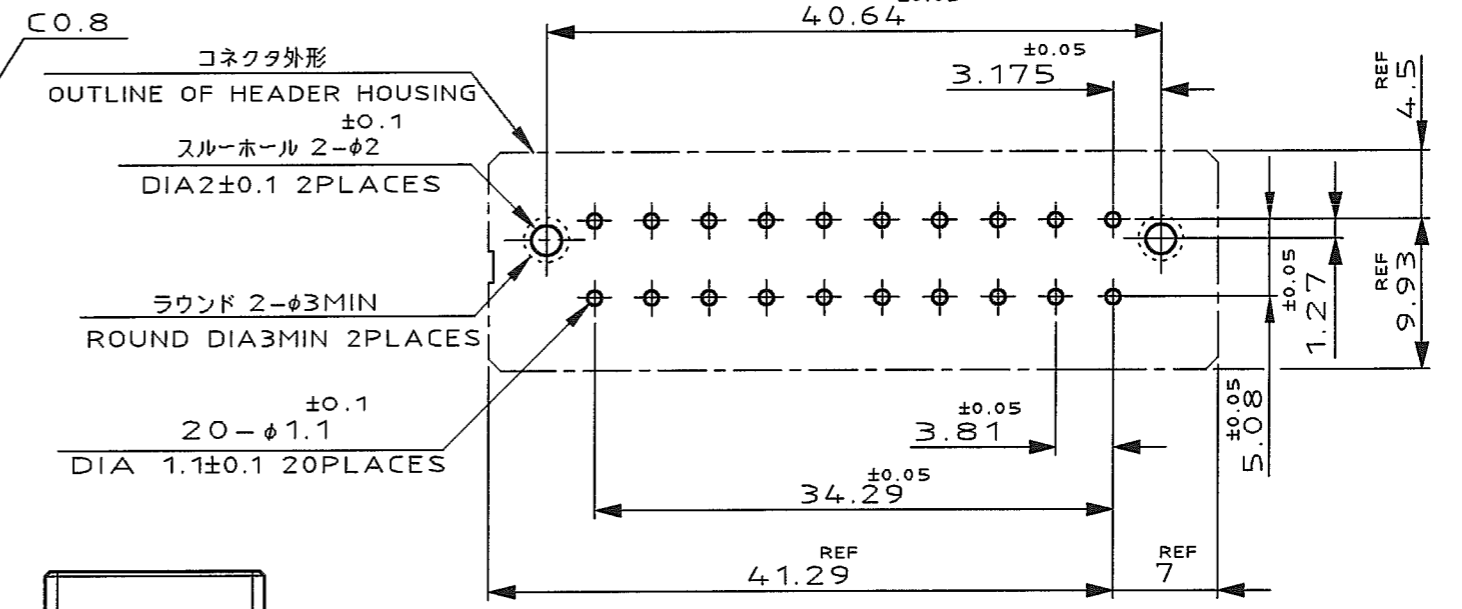
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



- △ 6 回路番号 CIRCUIT NO
- △ 6 リテンションレグ RETENTION LEG
- △ 6 コンタクト半田付部 CONTACT TAIL



推奨基板取付け寸法  
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
  - △ 2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - △ 3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
  - △ 4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
  - △ 5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
  - △ 6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

- 注記
1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒色  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
  - △ 2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
  - △ 3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
  - △ 4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
  - △ 5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土に半田めっき
  - △ 6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土にスズめっき

△ 6	△ 4	178328-5
△ 6	△ 3	178328-3
△ 6	△ 2	178328-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

D	REVISED (FJD0-0039-03)	T.S.M.	6/3
C	REVISED (FJD0-0114-03)	T.S.M.	25 APR '93
B	REVISED (FJ00-0838-94)	N.M.S.M.	7/4 '94
A	REVISED (FJ00-0480-94)	N.M.S.M.	4/20 '94
0	RELEASED (FJ00-0017-93)	Y.T.S.M.	2/8 '93
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK DATE

Copyright © 1993 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
WIRE RANGE	INSULATION DIA
MATERIAL	FINISH
DR. 20-JAN-'93 Y. TANAKA	DE. 20-JAN-'93 Y. TANAKA
CHK. 8-FEB-'93 S. MANABE	APP. 8-FEB-'93 S. MANABE

Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
NAME: 20 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	NUMBER
10mm: ±0.3 10mm 30mm: ±0.4 30mm 100mm: ±0.5 角度: ±3'	A3	J	C-178328
SCALE	REV.	SHEET	
2-1	D	1 OF 1	